第五届陶瓷封装（HTCC/LTCC/DPC）产业论坛

The 5th Ceramic packages（HTCC/LTCC/DPC）Industry Forum

邀请函

2026 年 12 月 24 日

浙江·嘉兴

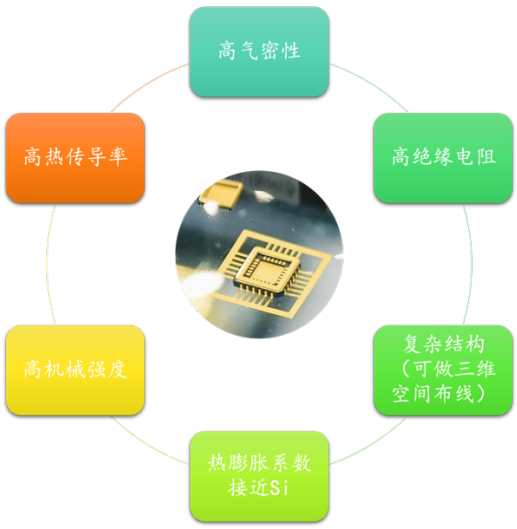
艾邦智造 GLEAD Electronics 佳利电子 北斗星通旗下企业

主办单位：深圳市艾邦智造资讯有限公司

协办单位：嘉兴佳利电子有限公司

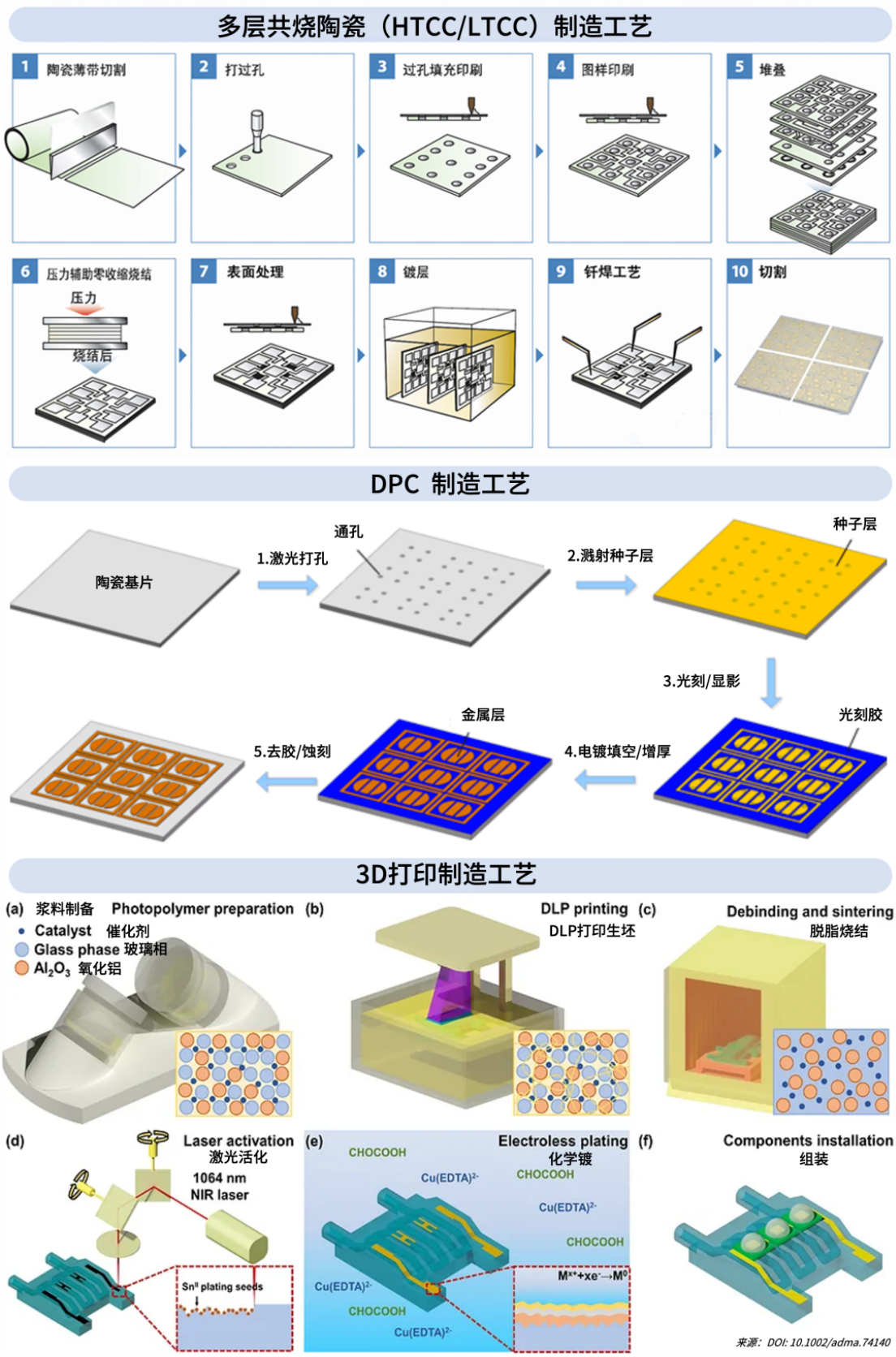
一、会议背景

电子封装技术在保障芯片功能、性能和可靠性方面发挥着至关重要的作用。电子封装材料作为整个电子封装技术的基础，主要用于芯片的电气连接、防潮散热、机械支撑、应力缓和等方面，目的是确保芯片及整个系统能在各种复杂多变的环境中正常、稳定工作。随着电子信息技术的发展，电子元器件逐渐向小型化、高度集成化、多功能化、高可靠性等方向发展，电子系统的集成度越来越高，功率密度越来越大，对封装材料的要求也越来越高。



陶瓷封装凭借其高介电性能、低损耗特性、接近硅片的热膨胀系数、高结构强度等特性，在航空航天、智能汽车、物联网、无人机、数据中心等领域实现了广泛应用。例如，陶瓷封装可解决高速光模块高热难题，适配 800G/1.6T 光模块及 CPO 新技术；基于 2.5D 封装的封装基板大型化和高密度布线正在加速，传统有机基板已经无法满足需求，多层陶瓷基板具有高刚性、低膨胀性，可作为下一代超大尺寸 AI 芯片封装解决方案。

近年来，物联网、新能源汽车等行业稳步发展，叠加商用航空航天、低空经济、天地一体化信息网络、人工智能（AI）数据中心高速光模块等新兴场景加速落地，成为微波器件、光传感、光模块等行业发展的重要驱动力，继而带动高可靠、高性能陶瓷封装的需求呈高速增长。根据 Fortune Business Insights 调研数据，2025 年全球陶瓷封装市场规模为 121.1 亿美元，预计 2026 年将达到 128.3 亿美元，到 2034 年将达到 211.亿美元，预测期内复合年增长率为 6.44%。亚太地区主导陶瓷封装市场，2025 年市场份额为 31.54%。


多层共烧陶瓷（HTCC/LTCC）制造工艺
1 陶瓷薄带切割
2 打过孔
3 过孔填充印刷
4 图样印刷
5 堆叠
6 压力辅助零收缩烧结
压力
烧结后
7 表面处理
8 镀层
9 钎焊工艺
10 切割
DPC 制造工艺
陶瓷基片
1.激光打孔
通孔
2.溅射种子层
种子层
3.光刻/显影
光刻胶
4.电镀填空/增厚
金属层
5.去胶/蚀刻
3D打印制造工艺
(a) 浆料制备 Photopolymer preparation
Catalyst 催化剂
Glass phase 玻璃相
Al2O3 氧化铝
(b) DLP printing
DLP打印生坯
(c) Debinding and sintering
脱脂烧结
(d) Laser activation
激光活化
1064 nm
NIR laser
Sn plating seeds
(e) Electroless plating
化学镀
CHOCOOH
Cu(EDTA)2-
(f) Components installation
组装
来源：DOI: 10.1002/adma.74140

△陶瓷封装主要制造工艺

目前陶瓷封装制造技术有高温共烧陶瓷技术（High Temperature Co-fired Ceramic，HTCC）、低温共烧陶瓷技术（Low Temperature Co-fired Ceramic，LTCC）以及直接电镀陶瓷技术（Direct Plating Copper,DPC）以及增材制造技术（3D 打印）等。涉及材料有氧化铝（Al_2O_3）、氮化铝（AIN）、氧化铍（BeO）、莫来石、氮化硅（Si_3N_4）、玻璃陶瓷复合材料、导电金属浆料等。

△往届论坛回顾

为把握陶瓷封装市场快速增长及国产化的窗口机遇，艾邦智造携手佳利电子将于 2026 年 12 月 24 日于浙江嘉兴举办第五届陶瓷封装（HTCC/LTCC/DPC）产业论坛，聚焦陶瓷封装领域新材料、新技术与新应用，诚挚邀请行业专家、学界学者莅临参会，一同探寻行业发展新路径，共掘产业发展新机遇。

二、活动安排

9 月 23 日（周三）：12:00—18:00 签到

9 月 23 日（周三）：14:00—17:00 参观佳利电子（具体安排待定，参观名额有限，先到先得）

9 月 24 日（周四）：7:30-8:50 签到；8:50—18:00 会议报告；18:00-19:30 晚宴

三、会议报告

序号	暂定议题	演讲嘉宾
1	光模块用陶瓷封装外壳与基板技术探讨（初拟）	中电科五十五所 副主任 邵金涛
2	HTCC 在半导体封装中的应用	郑州中科集成电路与系统应用研究院 先进封测中心副主任 周继瑞
3	增材制造赋能 LTCC 异形结构调控与性能优化	武汉理工大学 研究员 黄志峰
4	议题待定	西瑞米克
5	LTCC 封装技术	中国电科四十三所 集团公司专家 刘俊永
6	精密激光加工技术在陶瓷封装制造中的应用	紫宸激光 总经理 赵建涛
7	议题待定	上海航天技术基础研究所 专业主任师 赵立有
8	议题待定	电子科技大学 研究员 邢孟江
9	议题待定	北方微电子研究院
10	议题待定	佳利电子
11	面向半导体封装的多层陶瓷基板	拟邀请陶瓷封装企业/高校研究所
12	系统级封装（SiP）用陶瓷基板技术研发与产业化	拟邀请陶瓷封装企业/高校研究所

13	HTCC 氮化铝基板研究进展与产业化应用	拟邀请氮化铝基板企业/高校研究所
14	嵌入式微小流道多层陶瓷基板研究进展	拟邀请陶瓷封装企业/高校研究所
15	陶瓷封装技术在医疗领域的应用	拟邀请陶瓷封装企业/高校研究所
16	LTCC 技术在 5G/6G 通信领域的应用前景	拟邀请 LTCC 生产企业/高校研究所
17	基于 DPC 的 3D 成型陶瓷封装技术	拟邀请陶瓷封装企业/高校研究所
18	三维电镀陶瓷基板激光封焊技术	拟邀请陶瓷封装企业/高校研究所
19	低成本铜基 LTCC 体系研发与应用前景	拟邀请电子浆料企业/高校研究所
20	LTCC 金属浆料与生瓷带共烧匹配性研究	拟邀请 LTCC 材料企业/高校研究所

欢迎自荐或推荐演讲，题目自拟，演讲&展台赞助联系：温小姐 18126443075（同微信）

四、拟邀请企业类型

光通信、激光器、微波器件、模组、传感器、封装加工、消费电子、汽车电子、通信等企业；陶瓷封装、陶瓷管壳、陶瓷基板生产企业；氧化铝、氧化铍、氮化铝、氮化硅、玻璃陶瓷复合材料、焊料、金属浆料（钨、钼锰、金、银、铜）、可伐合金、热沉等材料企业；陶瓷粉体生产配制设备、粉体研磨机、砂磨机、流延机、3D 打印、冲孔机、印刷机、网板、叠片机、层压机、热切机、排胶烧结、承烧板、耐火材料、钎焊设备、电镀、化学镀、真空镀膜设备、蚀刻设备、显影设备、清洗设备、贴片机、引线键合机、封盖机、平行缝焊机、切筋机、打标机、X-RAY、AOI、外观检测、膜厚测试仪、氦气检漏仪、

性能检测、老化测试设备、自动化设备等设备及配件企业；科研院所、高校机构等。

五、往届演讲嘉宾

第二届陶瓷封装产业论坛演讲嘉宾

华中科技大学 教授
武汉利之达科技 创始人
陈明祥

德中技术
战略发展与市场总监
张卓

六方钰成
董事长
刘志辉

睿芯峰
副总经理
陈陶

东方泰阳
总经理
吴昂

天力创
项目经理
陈楠

佛大华康
高级工程师
刘荣富

七星华创微电子
工程师
任凯

友威科技
经理
林忠炫

上海越融科技
总经理
崔炜

中材高新氮化物陶瓷
首席专家
张伟儒

电子科技大学
研究员
邢孟江

嘉智信诺
董事长
陈永康

中国科学院理化技术研究所 高级工程师
中科新瓷 总经理
杨增朝

电子科技大学
教授
唐斌

郑州中科集成电路与系统应用研究院
先进封测中心副主任
周继瑞

长春工业大学
副院长
朱巍巍

上海航天技术基础所
专业主任师
赵立有

第三届陶瓷封装&微波陶瓷产业论坛演讲嘉宾

成都宏科电子
主任
廖榆文

成都旭瓷/宁夏北瓷
副总工程师
王明清

中电科四十三所
封装技术总监
刘俊永

富乐华
战略规划部部长
柳珩

青岛桥海陶瓷
总经理
刘在翔

吉安宏达秋
技术总监
李其宁

汇成真空
项目经理
周济增

南京工业大学
微波微电子封装材料中心主任
周洪庆

电子科技大学
教授
唐斌

恒锦智能
业务发展经理
韩政

佛大华康
总经理、高级工程师
刘荣富

长城钨钼
市场经理/工程师
易炼

江苏苏净
副总经理
梅毅文

泓湃科技
研发总监
谢合义

红星电子
副总经理/总工程师
彭翔

六、往届参会名单

姓名	职位	公司
崔**	营业企划部主管	三菱电机自动化(中国)有限公司
易**	市场经理	成都长城钨钼新材料有限责任公司
岳**	高级工程师	中电 29 所
方**	总经理	东莞市瑞纱光电技术有限公司
彭**	副总	重庆思睿创瓷电科技有限公司
张**	董事长	北京大华博科智能科技有限公司
谢**	董事长	浙江东瓷科技有限公司
张**	工艺总工	浙江东瓷科技有限公司
陈**	总经理	深圳市和兴盛光电有限公司
雷**	客户经理	成都泰美克晶体技术有限公司
江**	创始人	深圳市艾邦高分子科技有限公司
冯**	封装设计工程师	成都华微电子科技股份有限公司
柳**	战略规划部部长	江苏富乐华半导体科技股份有限公司
彭**	董事长	吉安宏达秋科技有限公司
周**	南工大微波微电子封装材料	南京工业大学/南京扬子工大科技有限公司
刘**	总经理	青岛桥海陶瓷新材料科技有限公司
刘**	集团公司专家、封装技术总	中国电子科技集团公司第四十三研究所封装事业部
梁**	总经理	湖南达诺智能新材料科技有限公司
庄**	董事长	湖南达诺智能新材料科技有限公司
张**	总工程师	湖南达诺智能新材料科技有限公司
王**	副总	辅成微电子科技（成都）有限责任公司
谢**	研发总监	苏州泓湃科技有限公司
赵**	市场	深圳市源驰科技有限公司
杜**	市场战略中心长	奕斯伟科技集团奕源
彭**	副总经理/总工程师	宜宾红星电子有限公司
韩**	业务发展经理	广东恒锦智能装备有限公司
唐**	教授	电子科技大学
秦**	销售经理	四川锦诚捷精密制版有限公司
刘**	董事长	四川六方钰成电子科技有限公司
冯**	业务经理	江苏一六仪器有限公司
高**	经理	大地達達建築設計諮詢有限公司
黄**	采购	成都超纯应用材料有限责任公司
冉**	生产经理	成都能斯特新材料科技有限公司
张**	总经理	成都旭瓷新材料有限公司
刘**	高级工程师	佛山市佛大华康科技有限公司
刘**	总经理	深圳市中星联技术有限公司
李**	技术总监	吉安宏达秋科技有限公司
杜**	总监	成都能斯特新材料科技有限公司
方**	销售经理	合肥费舍罗热工装备有限公司
张**	材料研发经理	成都汇通西电电子有限公司

汤**	营销经理	深圳市鑫贵金银提炼技术有限公司
李**	总工程师	贵阳顺络迅达电子有限公司
任**	首席专家	深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司
廖**	主任助理	成都宏科电子科技有限公司
李**	市场部助理	江苏富乐华功率半导体研究院有限公司
吴**	总经理	苏州市伊贝高温技术材料有限公司
王**	副总工程师	成都旭瓷新材料科技有限公司/宁夏北瓷新材料科技
韩**	总经理	广东恒锦智能装备有限公司
李**	博士	四川研瑞电子科技有限公司
孙**	总经理	成都思壮科技有限公司
陈**	经理	成都东谷精工机械有限公司
陈**	总经理	成都东谷精工机械有限公司
谌**	销售总监	济南金威刻激光科技股份有限公司
沈**	经理	上海傲鲲实业有限公司
王**	销售总监	北京凝华科技有限公司
边**	销售	常州市安视智能科技有限公司
张**	总经理	常州市安视智能科技有限公司
方**	销售总监	合肥费舍罗热工装备有限公司
高**	销售工程师	合肥费舍罗热工装备有限公司
文**	总经理	吉安宏达秋科技有限公司
杨**	技术总监	吉安宏达秋科技有限公司
董**	业务	吉安宏达秋科技有限公司
张**	技术主管	吉安宏达秋科技有限公司
戴**	工艺技术总监	北京七一八友晟电子有限公司
唐**	产品经理	中国电科 43 所
陈**	工程师	中国电子科技集团公司第四十三研究所
梁**	材料研发部长	浙江矽瓷科技有限公司
李**	大区经理	苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司
成**	研发中心主任	陕西华星电子集团有限公司
王**	总经理	广东省宏微智能装备有限责任公司
曾**	经理	成都雅华科技有限公司
周**	设备经理	成都能斯特新材料科技有限公司
金**	市场总监	株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司
周**	华西区销售副总	株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司
尚**	项目经理	广东山之风材料科技有限公司
李**		陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
姚**	技术总监	广东省宏微智能装备有限责任公司
钱**	销售经理	上海博枫贸易有限公司
范**	业务经理	石家庄明远科技有限公司
陈**	销售总监	深圳市中星联技术有限公司
高**	销售主管	深圳市中星联技术有限公司
鲁**	销售经理	四川景恒科技有限公司
熊**	特种电容厂副厂长	成都宏科电子科技有限公司

余**	销售主管	深圳市中星联技术有限公司
童**	销售经理	深圳市中星联技术有限公司
胡**	销售经理	深圳市中星联科技有限公司
谢**	总经理	萍乡市杰高新材料有限公司
许**	技术服务专员	苏州泓湃科技有限公司
吕**	高级创新经理	康宁显示科技(中国)有限公司
罗**	部门经理	四川锦诚捷精密制版有限公司
滕**	总经理	上海择势化学科技有限公司
张**	研发部长	成都能斯特新材料科技有限公司
江**	销售经理	深圳市领创精密机械有限公司
程**	项目管理	广东汇成真空科技股份有限公司
杨**	总经理	石家庄明远科技有限公司
杨**	技术	石家庄明远科技有限公司
赵**	常务副主任	中国电子科技集团公司第四十七研究所/辽宁省柔性
张**	总经理	四川盈鑫世纪新材料有限公司
徐**	市场部经理	成都旭瓷新材料有限公司
蒋**	副总经理	成都旭瓷新材料有限公司
张**	销售经理	宁夏北瓷新材料科技有限公司
赵**	嘉宾	成都旭瓷新材料有限公司
肖**	总经理	湖南聚能陶瓷材料有限公司
王**	副总经理	成都旭瓷新材料有限公司
黄**	技术部长	成都旭瓷新材料有限公司
石**	国际业务	成都旭瓷新材料有限公司
陈**	销售经理	宁夏北瓷新材料科技有限公司
罗**	事业部经理	成都旭光电子股份有限公司
左**	销售经理	苏州镁伽科技有限公司
陈**	区域销售经理	大连达利凯普科技股份公司
陈**	副总	上海择势化学科技有限公司
杨**	经理	上海择势化学科技有限公司
冯**	销售总监	上海东河机电科技有限公司
李**	总工程师	西安电子科技大学青岛计算技术研究院
魏**		合肥申为装备有限公司
姜**	总裁	苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司
邵**	副总经理	苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司
赵**	部长	北京七一八友晟电子有限公司
曹**	工艺总监	北京七一八友晟电子有限公司
严**	商务经理	潮州三环（集团）股份有限公司
陶**	销售经理	苏州伊尔赛高温无机耐材有限公司
刘**	销售经理	苏州伊尔赛高温无机耐材有限公司
白**	市场开发部销售主管	成都宏科电子科技有限公司
罗**	销售主管	成都宏科电子科技有限公司
杨**	销售主管	成都宏科电子科技有限公司
梅**	副总经理（技术总监）	江苏苏净工程建设有限公司

刘**	工程师	中国电子科技集团公司第十四研究所工会委员会
王**	销售主管	中国电子科技集团公司第二研究所
郝**	技术主管	中国电子科技集团公司第二研究所
李**	副部长	中国电子科技集团公司第二研究所
史**	长城钨钼总经理	成都长城钨钼新材料有限责任公司
高**	长城钨钼总经理助理	成都长城钨钼新材料有限责任公司
杨**	长城钨钼技术总监	成都长城钨钼新材料有限责任公司
陈**	钨钼事业部总经理	成都长城钨钼新材料有限责任公司
**	经理	深圳市领创精密机械有限公司
张**	研发中心技术员	陕西华星电子集团有限公司
黄**	工程师	湖南步悦金属有限公司
江**	GM	軒運科技股份有限公司
杨**	产品总监	济南金威刻激光科技股份有限公司
赖**	研究室主任	成都理工大学
赵**	部长	浙江矽瓷科技有限公司
李**	总经理	金华市芯瓷科技有限公司
章**	技术总监	金华市芯瓷科技有限公司
李**	销售经理	金华市芯瓷科技有限公司
孙**	学生	成都理工大学
范**	总经理	深圳市鑫陶窑炉设备有限公司
叶**	销售经理	深圳市鑫陶窑炉设备有限公司
黄**	销售经理	深圳市鑫陶窑炉设备有限公司
霍**	营销经理	广东省宏微智能装备有限责任公司
刘**	产品推广	厦门海赛米克新材料科技有限公司
李**	副總經理	日照旭日電子有限公司
赵**	销售总监	四川海恩特机械科技有限公司
吴**	销售经理	美尔森石墨工业(重庆)有限公司
王**	经理	湖南皓志科技股份有限公司
周**	经理	重庆东圳发丝印网版公司
周**	工程师	浙江东瓷科技有限公司
黄**	副总经理	青岛桥海陶瓷新材料科技有限公司
刘**	副总经理	青岛桥海陶瓷新材料科技有限公司
徐**	总经理	武汉欧双光电科技股份有限公司
赵**	基板事业部总经理	宜宾红星电子有限公司
周**	项目经理	广东汇成真空科技股份有限公司
张**	电镀经理	成都宏明双新科技股份有限公司
付**	技术型销售	河南北星精工技术有限公司
刘**	副教授	西南交通大学
段**	工程师	深圳铭测科技有限公司
安**	教授	西南交通大学
刘**	项目经理	贵阳顺络迅达电子有限公司
李**	技术部经理	秦裕精密网版（昆山）有限公司
陈**	工艺经理	成都宇熙电子技术有限公司

杨**	采购	成都宇熙电子技术有限公司
吴**	副总经理	成都四派科技有限公司
王**	技术总监	成都四派科技有限公司
柏**	产品工程师	成都火炬电子股份有限公司
韩**	市场主管	深圳市和兴盛光电有限公司
杨**	产品经理	上海移远通信技术股份有限公司
吴**	FAE 工程师	江苏瀚思瑞半导体科技有限公司
杨**	高级工程师	中国电科 29 所
胡**	华南区销售副总	株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司
张**	技术经理	武汉欧双光电科技股份有限公司
孙**	研发工程师	中航富士达科技股份有限公司
周**	销售经理	四川用从忠科技有限公司
赵**	设计师	成都宏科电子科技有限公司
刘**	研发中心主任	洛阳布鲁姆电子科技有限公司
陈**	副总工程师	成都亚光电子股份有限公司
刘**	研六所顾问	成都亚光电子股份有限公司
钟**	研究所所长	亚光电子股份有限公司研六所
汪**	烧结主任	成都亚光电子股份有限公司
魏**	技术	度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司
张**	销售工程师	上海卓盛程新材料科技有限公司
曹**	项目经理	中江立江电子有限公司

七、报名方式

方式一：加微信	方式二：
温小姐：18126443075（同微信） 邮箱：wenxiaoting@aibang.com 扫码添加微信，咨询活动详情 注意：每位参会者均需要提供信息	扫描二维码在线登记报名 或复制网址到浏览器后，微信注册报名 https://www.aibang360.com/m/100333

八、收费标准

参会人数	1~2 个人	3 个人及以上
10 月 22 日前付款	2600 元/人	2500 元/人
11 月 22 日前付款	2700 元/人	2600 元/人
12 月 22 日前付款	2800 元/人	2700 元/人
现场付款	3000 元/人	2800 元/人

注意：费用包括会议门票、会议资料、午餐、茶歇等，但不包括住宿；下游应用终端、高校师生有优惠。

九、赞助方案

项目	服务内容
协办单位	30 分钟主题演讲（企业领导致辞 10 分钟）
	赠送 8 个参会名额
	商标 logo、企业名称，展示顺序优先
	大号展示台及背景喷绘（宽度 4m），选位顺序优先
	会刊广告 1P，页码顺序优先
	参会证/桌牌企业 logo 展示，2 选 1
	资料入袋
	现场易拉宝展示位 1 个
	礼品赞助
	2 分钟企业宣传片，于茶歇环节循环播放
	微信软文推送/会议线上通讯录 banner 横幅广告，2 选 1
	25 分钟主题演讲
	5 个参会名额

主题演讲+现场标准展台	商标展示：背景板 Logo、会刊封面 Logo
	会刊页印刷(演讲嘉宾 PPT 印刷)
	现场展示台，含 2*3m 背景板，主办方提供搭建，客户自行提供设计
主题演讲	30 分钟主题演讲，2 个参会名额
	会刊页印刷 (演讲嘉宾 PPT 印刷)
大号展示台	现场展示台（宽度 4m），展示设备及样品、资料以及洽谈
	主办方提供喷绘背景板搭建，客户自行设计（设计稿规格要求：宽*高 200cm*112.5cm，分辨率 100 以上，格式为 PSD 或 AI 原文件）
	6 个参会名额
	优先选择展位位置
	（二选一）会刊广告内彩 1P 或资料入袋
标准展示台	现场展示台（宽度 2m），展示设备及样品、资料以及洽谈
	主办方提供喷绘背景板搭建，客户自行设计（设计稿规格要求：宽*高 200cm*112.5cm，分辨率 100 以上，格式为 PSD 或 AI 原文件）
	3 个参会名额
双侧屏广告（独家）	主讲屏幕 LED 电子侧屏，双边侧屏广告，会议期间全天独家展示（客户自行设计，图片尺寸以实际面积为准）
单侧屏广告（独家）	主讲屏幕 LED 电子侧屏，单边侧屏广告，会议期间全天独家展示（客户自行设计，图片尺寸以实际面积为准）
单侧屏广告（轮播）	主讲屏幕 LED 电子侧屏，单边侧屏广告，会议期间全天轮播展示（客户自行设计，图片尺寸以实际面积为准）
企业宣传片播放	茶歇时间于大屏幕上播放企业宣传片，视频时长不超过 3 分钟
Banner 线上广告	植入在会议线上通讯录置顶的横幅广告，有效期 6 个月

会刊广告（封面）	研讨会会刊封面页，与主办方及大会内容并行的彩色全页广告（尺寸 210*285mm）
会刊广告（封底）	研讨会会刊封底页，与主办方及大会内容并行的彩色全页广告（尺寸 210*285mm）
会刊广告（前扉）	研讨会会刊翻开后第一页，与主办方及大会内容并行的彩色全页广告（尺寸 210*285mm）
会刊广告（封二）	研讨会会刊翻开后第二页，与主办方及大会内容并行的彩色全页广告（尺寸 210*285mm）
会刊广告（内彩）	研讨会会刊内页任意一页随机分配（除前扉与封二以外），与主办方及大会内容并行的彩色全页广告（尺寸 210*285mm）
参会证赞助（独家）	参会证背面单面印刷广告
资料袋赞助（独家）	印有企业标识的资料袋
桌牌赞助	印有企业标识的桌牌
椅套赞助	印有企业标识的椅套
笔记本/纸笔赞助（独家）	全场指定赞助商冠名笔记本/手写纸/签字笔上桌摆放，参会者每人一套（赞助商自带）
资料入袋赞助	企业的宣传册（不超过 6P）放入参会袋子
易拉宝	现场 1 个易拉宝展示（赞助商自带，主办方提供摆放位置）
礼品赞助	印有赞助商 Logo 的礼品，用于赠送参会听众（赞助商自带）
微信推送	微信公众号于会前、会中或者会后，企业介绍以及相关软文一共 1 篇
视频推送	微信视频号于会前、会中或者会后，由企业提供介绍视频转载 1 条